

**ADVANTEST**<sup>®</sup>



# 2023年度（2024年3月期） 決算説明会

2024年4月26日  
株式会社アドバンテスト

All Rights Reserved - ADVANTEST CORPORATION

# ご注意

---

## 会計基準について

- 本プレゼンテーション資料に記載されている実績や見通し数値は、国際会計基準（IFRS）に基づいて作成しています。

## 将来の事象に係る記述に関する注意

- 本プレゼンテーション資料およびアドバンテスト代表者が口頭にて提供する情報には、将来の事象についての、当社の現時点における期待、見積りおよび予測に基づく記述が含まれております。これらの将来の事象に係る記述は、当社における実際の財務状況や活動状況が、当該将来の事象に係る記述によって明示されているものまたは暗示されているものと重要な差異を生じるかもしれないという既知および未知のリスク、不確実性その他の要因が内包されており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。

## 本資料の利用について

- 本プレゼンテーション資料に記載されている情報は、各国の著作権法、特許法、商標法、意匠法等の知的財産権法その他の法律及び各種条約で保護されています。事前に当社の文書による承諾を得ない限り、法律によって明示的に認められる範囲を超えて、これらの情報を使用（改変、複製、転用等）することを禁止します。

# 2023年度決算報告

経営執行役員  
CFO & CSO (Chief Strategy Officer)  
経営戦略本部長 三橋 靖夫

All Rights Reserved - ADVANTEST CORPORATION

**ADVANTEST**<sup>®</sup>

## FY23業績総括

- FY23通期の売上高、営業利益、当期利益は前年度比で減収減益
- しかしながら、SoCテスト、メモリ・テストの両市場でマーケットシェアを拡大
- 生成AI関連で高性能DRAM向け売上が増加。一方で、SoCテスト市場が想定以上に減速
- 製品ミックスでは、高収益を生む先端プロセス向けSoCテストの売上比率が低下
- 減収率は、軟調な市況の中でも22年7月時点の当社予想<sup>\*1</sup>の範囲内にとどまる

\* 1: 22年7月の第2期中期経営計画 改訂時のFY23売上高想定 前年度比-約15%~+約10%

### ○ 2023年度業績総括

- 不確実な事業環境が続く中、当社ビジネスを継続して支えていただいているお取引先各社をはじめ、従業員、すべてのステークホルダーの皆様に感謝申し上げます。
- 2023年度の業績は、過去最高の業績を達成した前年度と比較して、減収減益の着地となりました。
- 市場シェアに関しては、SoCテスト、メモリ・テストの両市場でさらなるシェア拡大を果たすことができました。
- 生成AI関連で高性能DRAM向けテストの売上が大きく伸びたものの、スマートフォン市況の停滞やサーバー投資の減速などから、SoCテストの売上が落ち込みました。
- このような軟調な市況の中でも、売上高は、2022年7月に第2期中期経営計画（MTP2）を改訂した際に予想した減収率内にとどまりました。しかしながら、先端プロセス向けSoCテストの想定を超える売上の落ち込みから、収益性に対する製品ミックスが大幅に変化しました。
- 2023年度はMTP2の最終年度でした。MTP2の結果についてはプレゼン後半でご説明したいと思います。

## FY23業績概要

(億円)

	FY22	1月時点 予想	FY23	前年度比	
	実績		実績	増減額	増減率
売上高	5,602	4,800	4,865	-737	-13.2%
営業利益	1,677	850	816	-861	-51.3%
営業利益率	29.9%	17.7%	16.8%	-13.1pts	
税引前利益	1,713	825	782	-931	-54.4%
当期利益	1,304	645	623	-681	-52.2%
当期利益率	23.3%	13.4%	12.8%	-10.5pts	
為替レート	1米ドル	134円	143円	143円	9円 円安
	1ユーロ	140円	154円	155円	15円 円安
1株当たり配当額（年間）*1	33.75円	-	34.25円*2	+0.5円	
自己株式取得額	500	-	-	-	
総還元性向*3	58%	-	41%	-17pts	

\* 1:当社は、2023年10月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。上記1株当たり配当金はFY22期首に株式分割が行われたと仮定しての数値を記載しています。

\* 2:FY23の期末配当は2024年5月21日開催の取締役会において正式決定する予定です

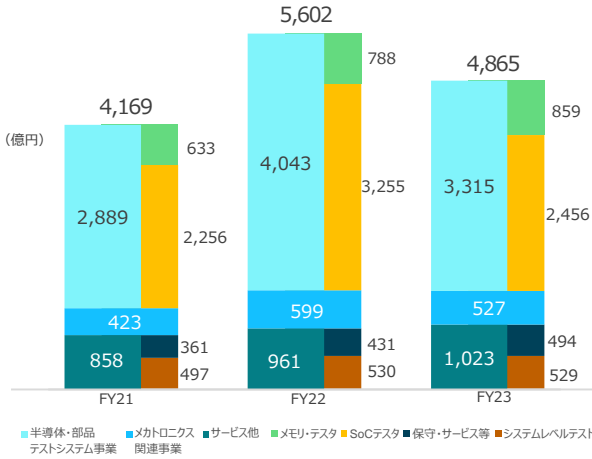
\* 3:総還元性向=(配当総額+自己株式取得額)÷当期利益

### ○ 2023年度業績概要

- 売上高および営業利益、当期利益は前年度から大きく減少しました。
- 1月時点の通期予想との比較では、メモリ・テスト中心に顧客への製品納入が想定以上に進捗したことから、売上高は通期予想をやや上回りました。
- しかしながら、第4四半期にのれんの一部減損損失約90億円をその他の費用で計上したことから、営業利益は通期予想を下回りました。
- 一時的な営業損益を控除した、いわゆるコア営業利益は871億円、コア営業利益率は17.9%でした。
- 当期利益につきましても通期予想を下回る結果となりました。
- なお、税金費用には将来一定期間に実現する可能性が高い繰延税金資産約38億円を第4四半期に計上しており、実効税率が約20%とやや低くなりました。
- 期末配当予想は18円、中間配当実績16.25円と合わせ、年間配当予想は34.25円とします。

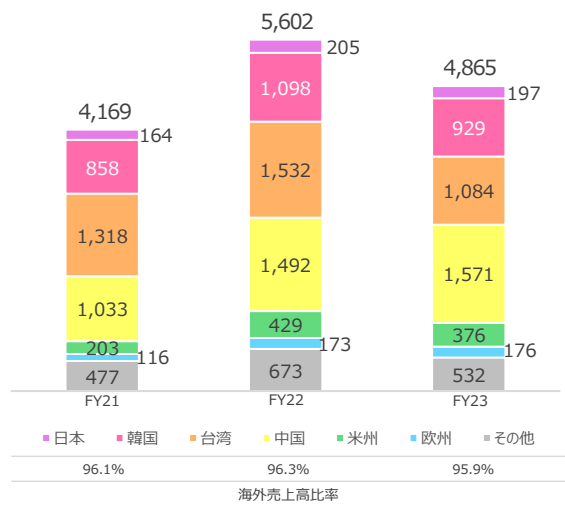
# FY23売上実績 年度比較

## <事業別売上>



\*合計にはセグメント間の内部取引の消去分が含まれます

## <地域（出荷先）別売上>



## ○ 2023年度の売上高実績

- こちらは事業別、地域別での売上実績年度比較です。
- 2022年度までの過去3年度にわたり多くのテストを顧客に納入していたことと、市場の停滞が相まって、顧客設備の稼働率が低く推移したことから、当社製品の需要が落ち込みました。
- 事業別で見ると、SoCテストでは、車載や産業機器などの成熟プロセス品向けの販売は堅調だったものの、スマートフォンやパソコンなどの主要な民生機器やデータセンタに関連した先端プロセス品向けの売上が減少しました。
- メモリ・テストは、高性能DRAMに向けた旺盛な試験装置需要や、中国メモリ企業向け売上の伸長により前年度を上回りました。
- 製品仕向け先でみた地域別では、ハイエンドSoC向けを中心に、台湾向けの売上が大きく落ち込みました。

## 四半期業績推移

(億円)

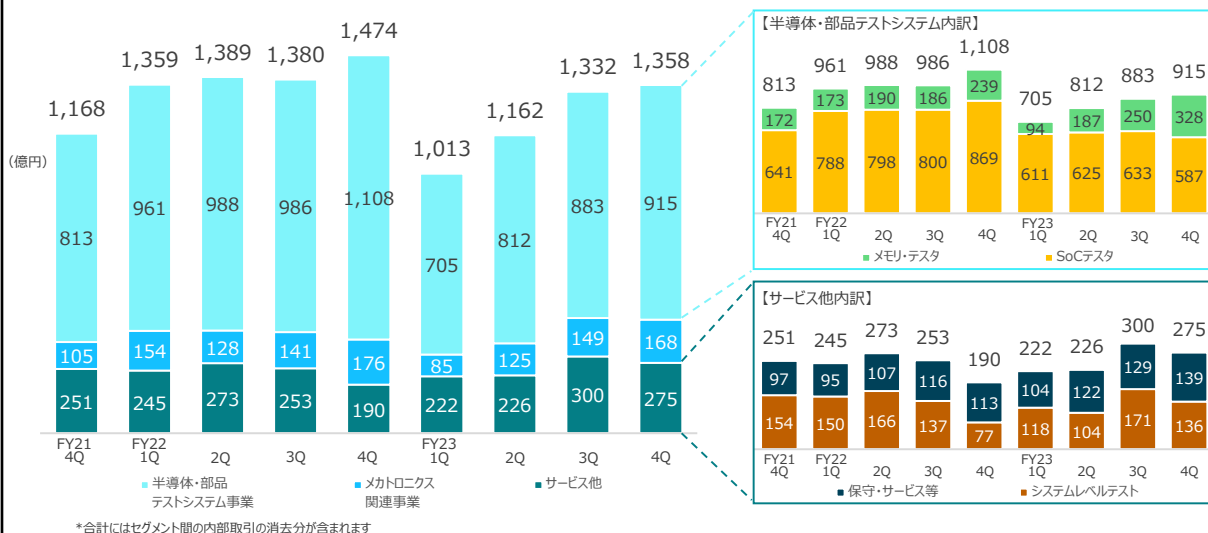
	FY22				FY23				前期比		前年同期比	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	増減額	増減率	増減額	増減率
売上高	1,359	1,389	1,380	1,474	1,013	1,162	1,332	1,358	+25	+1.9%	-116	-7.9%
売上総利益	789	799	816	787	510	580	674	696	+22	+3.3%	-91	-11.5%
売上総利益率	58.1%	57.5%	59.1%	53.4%	50.3%	49.9%	50.6%	51.3%	+0.7pts		-2.1pts	
営業利益	448	431	412	386	143	210	268	195	-73	-27.2%	-190	-49.3%
営業利益率	32.9%	31.1%	29.9%	26.2%	14.1%	18.1%	20.1%	14.4%	-5.7pts		-11.8pts	
税引前四半期利益	484	468	377	384	130	203	263	186	-76	-29.1%	-198	-51.6%
四半期利益	365	347	286	306	92	167	212	152	-61	-28.6%	-154	-50.5%
四半期利益率	26.8%	25.0%	20.8%	20.8%	9.1%	14.4%	15.9%	11.2%	-4.7pts		-9.6pts	
為替レート	1米ドル 1ユーロ	124円 134円	135円 139円	144円 144円	133円 142円	135円 146円	142円 156円	149円 159円	147円 159円	2円 円高	14円 円安	17円 円安
1株当たり配当額*1	-	16.25円 (65円)	-	17.50円 (70円)	-	16.25円 (65円)	-	18円	-	-	-	+0.5円

\*1:当社は、2023年10月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。上記1株当たり配当金はFY22期首に株式分割が行われたと仮定しての数値を記載しています。(カッコ内は分割前の値)

### ○ 2023年度第4四半期の業績概要

- ・ 第4四半期実績はご覧の通りです。
- ・ 業績の詳細は以降のスライドで順次ご説明いたします。

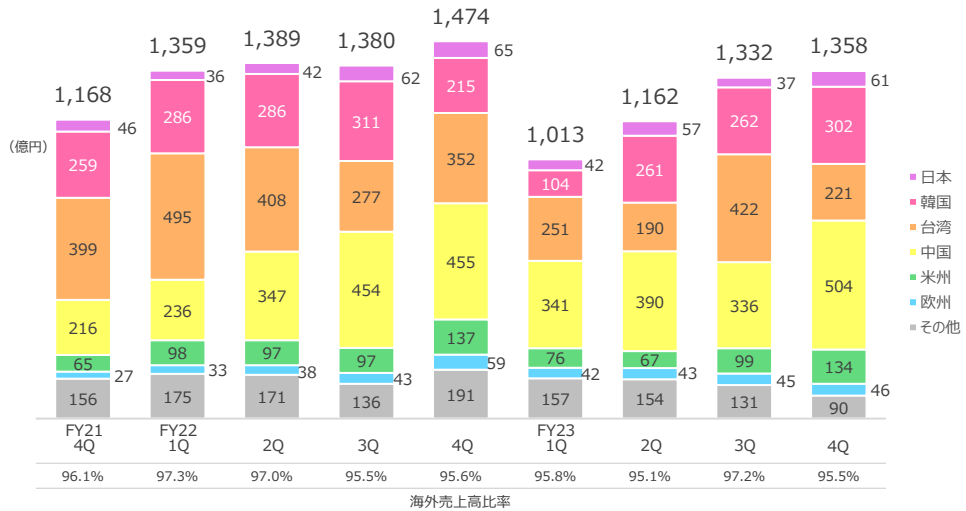
## 四半期売上高 事業セグメント別



- 2023年度第4四半期の売上高
- 半導体・部品テストシステム事業
  - ・ SoCテストは、前期比47億円減の587億円でした。
  - ・ アプリケーション・プロセッサ（APU）向けでは、前期に一部前倒し売上があった反動もあり、前期比で減収となりました。一方で、ハイ・パフォーマンス・コンピューティング（HPC）やAI関連の半導体向けの売上が伸長したことから、先端プロセス品向けは、前期から微減にとどまりました。
  - ・ 他方で、車載・産業機器などの成熟プロセス品向けは、上期は堅調であったもの下期に入り弱含みが見られ、前期に引き続き減収となりました。
  - ・ メモリ・テストは、前期比79億円増の328億円でした。生成AI関連での高性能DRAM向けの旺盛な需要に加え、中国DRAM企業向けの売上も伸長しました。
- メカトロニクス関連事業
  - ・ ナノテクノロジー製品でまとまった出荷があり、売上が増加しました。
- サービス他
  - ・ 特定顧客向けの比率が高いシステムレベルテスト（SLT）事業において、前期に製品納入が進んだことによる反動減があり、減収となりました。



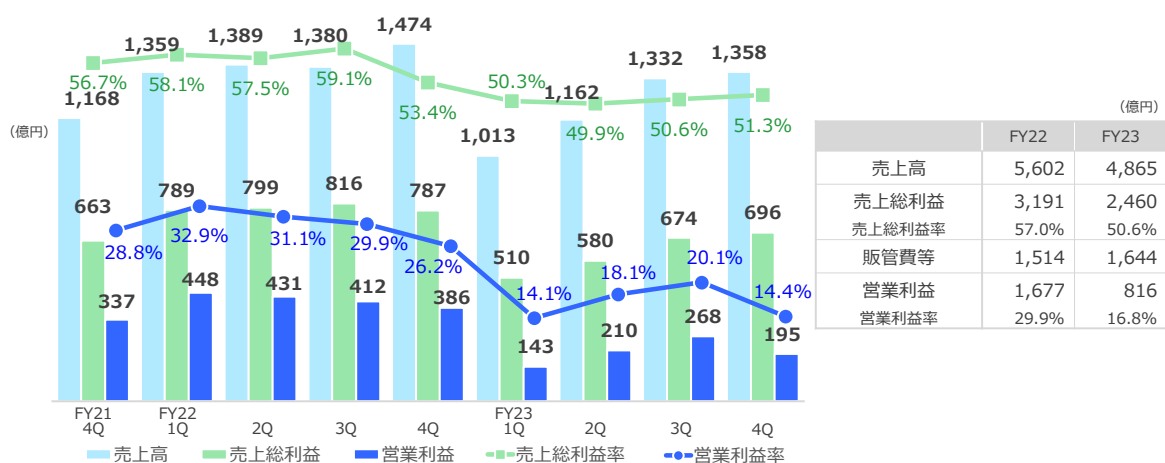
## 四半期売上高 地域(出荷先)別



### ○ 2023年度第4四半期の地域別売上高

- 台湾**  
 前ページでご説明した、ハイエンドSoC向けでの前期の一部前倒し売上の影響もあり、前期比でSoCテストの売上が大幅に減少しました。またSLTの売上也落ち込みました。
- 中国**  
 SoCテストおよびメモリ・テストでそれぞれ売上が伸長しました。
- 韓国**  
 DRAM向けを中心とする旺盛な顧客の投資意欲は継続しており、メモリ・テスト売上が増加しました。

## 売上高/売上総利益/営業利益



### ○ 2023年度第4四半期の売上高/売上総利益/営業利益

- 売上総利益率は前期比で微増しました。
- 販売費および一般管理費等（その他収益・費用を合算）は、前期比で95億円増加しました。
- こちらは前述の通り、のれんの一部減損損失約90億円をその他の費用で計上したことによるものです。
- この減損に関しましては、2019年度に買収した、テストソケットに関連するEssai社のビジネスにおいて、大口顧客向けの売上予想が落ち込み、想定していた将来キャッシュ・フローの見通しが悪化したことが背景です。
- 実質ベースの販管費は前期比でほぼ同水準でした。

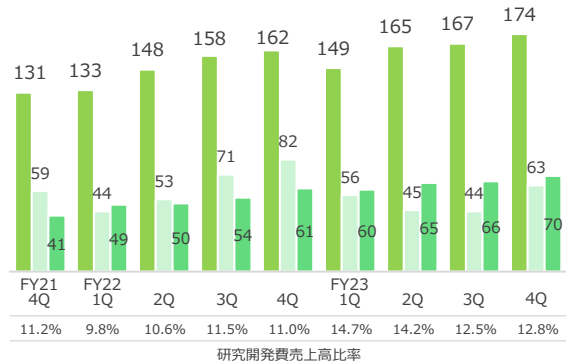
## 投資等/キャッシュ・フロー

### <投資等>

- 研究開発費
- 設備投資
- 減価償却費

	FY22	FY23
研究開発費	601	655
売上高比率	10.7%	13.5%
設備投資	250	208
減価償却費	214	261

(億円)

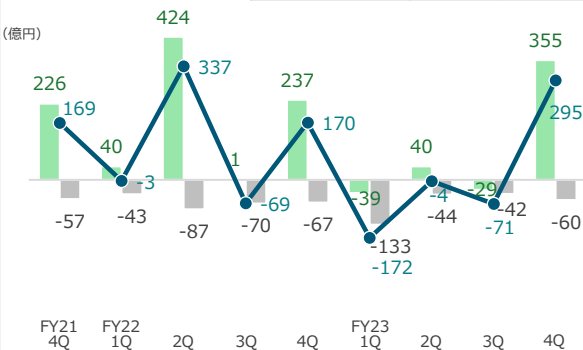


### <キャッシュ・フロー>

- 営業キャッシュ・フロー
- 投資キャッシュ・フロー
- フリー・キャッシュ・フロー

	FY22	FY23
営業キャッシュ・フロー	702	327
投資キャッシュ・フロー	-267	-279
フリー・キャッシュ・フロー*	435	48

(億円)



\*フリー・キャッシュ・フロー = 営業キャッシュ・フロー + 投資キャッシュ・フロー

### ○ 2023年度第4四半期の研究開発費等

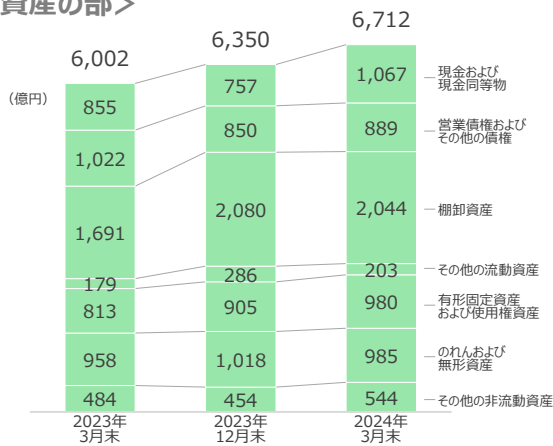
- ・ 研究開発費、設備投資、減価償却費はこちらの通りです。
- ・ 年度末ということもあり、研究開発費や設備投資は前期比で増加しました。

### ○ 2023年度第4四半期のキャッシュ・フローの状況

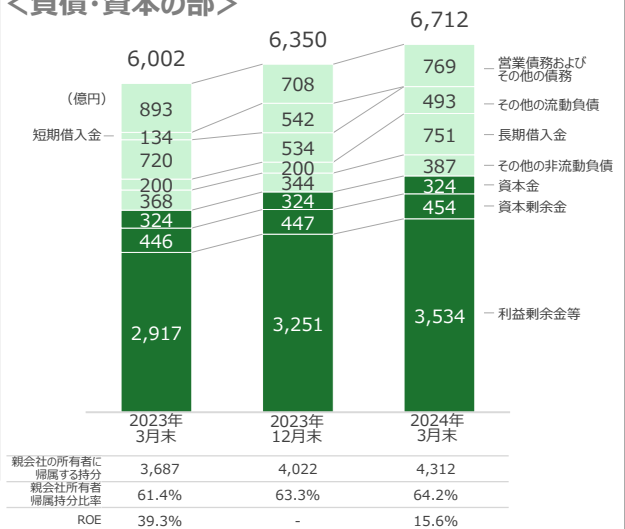
- ・ 第4四半期は、前期のような法人税や賞与の支払いがなかったことに加えて、棚卸資産がやや減少したことなどから、営業キャッシュ・フローが大きく伸びました。

# 連結財政状態

## <資産の部>



## <負債・資本の部>



### ○ 2024年3月末時点のバランス・シート

- 資産の部では、棚卸資産が、若干ながら前期比で減少しました。
- 負債の部では、運転資金を鑑み、短期借入金を長期借入金へと借り換えました。
- 2023年度を通しては、中長期を見据えた戦略的な在庫積み増しや、高性能DRAM向けを中心に、需要が旺盛な領域への供給能力増強に取り組みました。また、SoC テスタを中心に顧客の延伸要求への対応などもあり、棚卸資産が前年度に比べて大きく増加しました。
- 資本効率も低下していることから、サプライチェーン管理の高度化を推進し、棚卸資産の早期の資金化に努めていきます。

## 第2期中期経営計画（MTP2、FY21-23）の結果

想定以上の市場減速やミックス変化を受け、売上高は下限値を超過したものの収益性と資本効率目標は未達

	第1期中計実績 FY18-20平均	第2期中計 当初目標 (2021年5月) FY21-23平均	第2期中計目標 (2022年7月修正) FY21-23平均	FY21実績	FY22実績	FY23実績	第2期中計実績 FY21-23平均
売上高	2,904億円	3,500~3,800億円	4,800~5,200億円	4,169億円	5,602億円	4,865億円	4,879億円
営業利益率	22.3%	23~25%	27~30%	27.5%	29.9%	16.8%	24.7%
当期利益	601億円	620~700億円	980~1,200億円	873億円	1,304億円	623億円	933億円
ROE	29.1%	20%以上	30~35%	30.4%	39.3%	15.6%	28.4%
1株当たり 当期利益 (EPS)*1	77円	80~93円	128~158円	112円	174円	84円	124円
設備投資*2	302億円	(枠) 400億円	(枠) 700億円	180億円	250億円	208億円	639億円
M&A等戦略投資*2	477億円	(枠) 1,000億円	(枠) 1,000億円	290億円	35億円	83億円	407億円
株主還元額*2 (配当額+自己株式取得)	617億円	(想定) 1,500億円以上	(想定) 2,100億円以上	930億円	750億円	253億円	1,934億円
総還元性向	39%	(方針) 通期総還元性向50%以上を目標		107%	58%	41%	69%

\*1: 当社は、2023年10月1日を効力発生日として、普通株式1株につき4株の株式分割を行ったため、従来の公表値から変更しています

\*2: 第2期中計期間の設備投資、M&A等戦略投資の投資枠および株主還元額の想定は3年累計での金額となります

13 | ADVANTEST

All Rights Reserved - ADVANTEST CORPORATION

### ○ 第2期中期経営計画（FY21-23）の結果

- 最後に、第2期中期経営計画、MTP2の結果についてご説明します。2021年5月に公表した当初目標は全て達成したものの、2022年7月に公表した修正目標に対しては、表中にお示ししたとおり、売上高を除き未達に終わりました。
- 3年間を振り返ってみると、事業環境は短期間に大きく変化いたしました。前半は、社会のデジタル化の進展が半導体の高性能化を促すと同時に、半導体の供給能力の増強を推し進めました。しかし、後半では、生成AI関連の一部高性能な半導体の需要は活発であったものの、主要な民生品向けの半導体市場は調整局面入りし、テスト市場も急速な拡大ののち、減速しました。
- そのような環境下でも、HPC/AIやHBMなどの複雑性が進行する高性能半導体向けで、先端技術開発に取り組む、リーダー顧客や新規参入者のテスト需要をとらえることができ、シェアをMTP2期間、3年継続して拡大することができました。
- 半導体需給の短期間サイクルでの変動は今後も繰り返されるものの、半導体の高性能化を追求する複雑性の進行は、継続する流れを見えています。新たな半導体市場への参入者の登場も含めて、半導体テスト市場は、MTP2がMTP1を上回って着地したように、中長期的に成長を続けると見込んでいます。
- 今後の課題としては、製品ミックスに左右されない強固な収益性を如何に確保するかが重要だと認識しています。
- 当社の最低保有現金水準1,000億円や運転資金ニーズおよび成長投資機会などを考慮した結果、2023年度単年度の株主還元は配当のみといたしました。そのため、通期総還元性向は50%を下回る結果となりました。MTP2期間の3年間累計での総還元性向は50%を超えております。

# 2024年度事業見通し

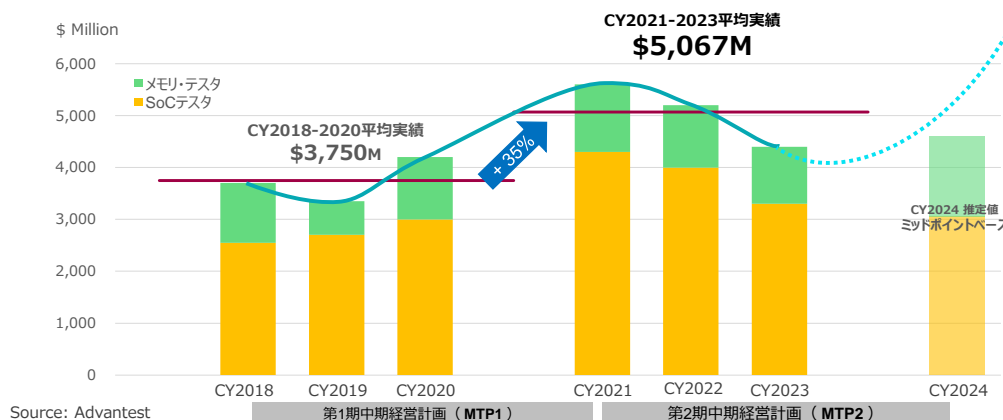
代表取締役 兼 経営執行役員 Group CEO Douglas Lefever

All Rights Reserved - ADVANTEST CORPORATION

**ADVANTEST**<sup>®</sup>

## テスト市場の推移

- ✓ MTP1とMTP2の3か年平均のテスト市場規模は35%増加
- ✓ MTP3期間における市場前提は、精査途上であるが、テスト市場はCY23をボトムと見込む。CY24以降は、半導体がAIによりさらに複雑化することで、テスト需要はさらに拡大。新たなシクリカルグロース局面入りへ。

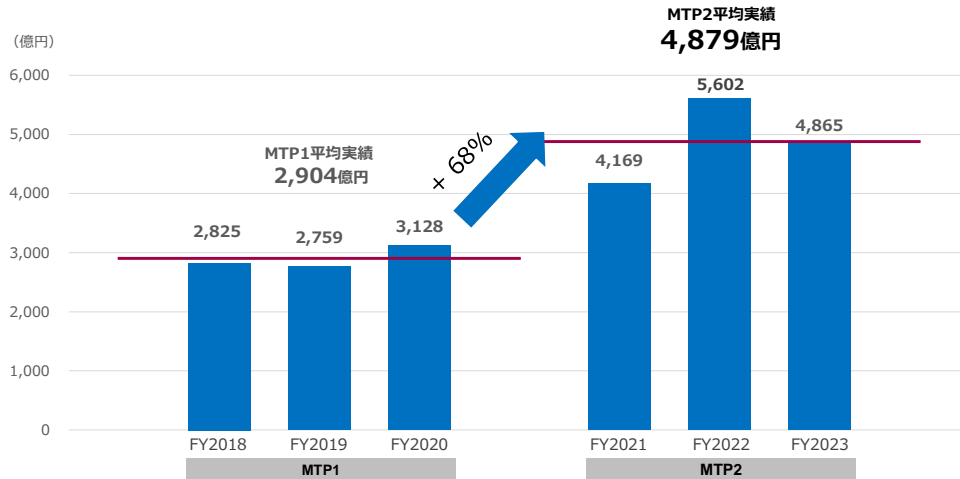


### ○ テスタ市場の推移

- MTP1とMTP2の3か年平均のテスト市場規模を比較すると、MTP2でのテスト市場は35%増加しました。
- MTP3の市場規模の想定は精査途上ですが、暦年2023年がボトムと見込んでいます。2024年以降は、AIにより半導体がさらに複雑化することで、テスト需要はさらに拡大し、新たなシクリカルグロース局面に入ると予想します。
- 2024年-2026年の見方を整理すると、2024年のテスト市場は、堅調なHPC/AI関連の需要は拡大基調に転じると見ています。一方で、スマートフォンやPCなどの最終市場の回復が遅れていること、自動車や産業機器市場が低調であることから、2024年のテスト市場は2023年から微増と推定しています。
- 2025年はHPC/AI向けを含む先端ロジック半導体の旺盛な需要、成熟プロセスのSoC半導体の需要回復およびハイエンド・メモリのさらなる需要拡大に支えられ、半導体テスト市場全体が持ち直し、過去最高を更新するものと見ています。
- 2026年もHPC/AI関連需要に牽引され、半導体テスト市場は2025年に引き続き、2年連続で過去最高を更新するものと想定します。
- また、両年ともに、先端ロジック半導体やハイエンド・メモリのさらなる数量増加と性能向上により、システム・レベル・テストや、特にハイエンドSoC向けのテスト周辺機器などへの需要も促進されるものと考えます。

## 当社売上高推移

- ✓ MTP2における3か年平均の当社売上高は、MTP1比68%増加
- ✓ 為替面の好影響もあるが、市場シェア上昇を主因に当社の売上成長は同期間のテスト市場の伸び率を上回る



### ○ 当社売上高推移

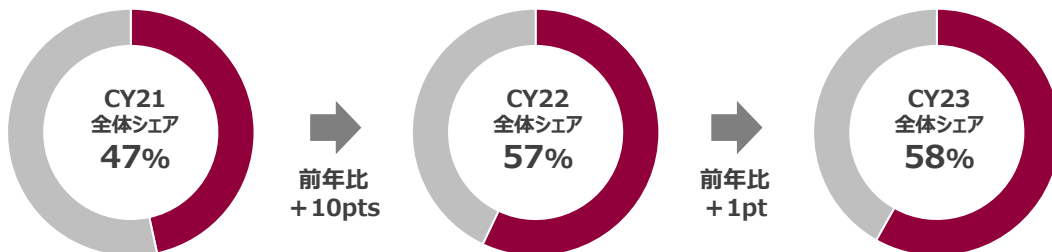
- MTP2における3か年平均の当社売上高は、MTP1と比べて68%増加しました。
- 当社の売上成長率は、前ページのテスト市場の伸び率を上回っています。これは為替面の好影響もありますが、テスト市場での当社シェア上昇が主因となります。
- テスタ市場全体の拡大は、当社にとってチャンスです。HPC/AIといったハイエンド・アプリケーションにおける長年にわたり培ってきた強みとともに、当社のソリューション・ポートフォリオの総合力を活用することができます。
- 中期的なベースラインは、半導体テスト市場で50%のシェアを確保することですが、これまで同様、さらなる高みを目指していきます。



## 半導体テスト市場およびシェアの状況

市場規模 約\$5.6B 前年比-6% → 約\$5.2B 前年比-15% → 約\$4.4B

■ 当社  
■ 他社



	市場規模	当社シェア
SoCテスト	約\$4.3B	45%
メモリ・テスト	約\$1.3B	51%

	市場規模	当社シェア
SoCテスト	約\$4.0B	58%
メモリ・テスト	約\$1.2B	53%

	市場規模	当社シェア
SoCテスト	約\$3.3B	59%
メモリ・テスト	約\$1.1B	56%

Source: Advantest

### ○ 半導体テスト市場およびシェアの状況

- 暦年ベースの2023年の半導体テスト市場は、SoCテストは約33億米ドル、メモリ・テストは約11億米ドル、合計約44億米ドルと、対前年成長率はマイナス15%程度の規模であったと推定しています。
- 高性能半導体向けの技術進化がテスト需要をけん引する一方で、それら需要は余剰設備の消化に向けられたことや、主要民生機器向けの半導体需要の落ち込みの影響が長引いたことから、2年連続の市場規模縮小となりました。
- マーケットシェアは、58%程度と、前年から1ポイントほど伸ばすことができたのではないかと試算しています。SoCテストではおよそ59%、メモリ・テストではおよそ56%とそれぞれ3年連続で首位を獲得したものとみています。
- 2023年は市場規模が縮小する中で、特に今後の重要な市場である、HBMやHPC/AIといった高性能半導体向けテスト市場において当社はマーケットシェアを拡大し、売上を伸ばすことができました。

## 事業環境と半導体テスト市場の動向 <24年4月時点の見方>

### <事業環境>

- 世界経済の景気後退懸念は、依然として払拭されていない。加えて地政学的リスクの拡大や急激な為替変動リスクなど、CY24も不確実性の高い状況は継続
- 半導体需給の改善が期待されるとともに、生成AI関連の投資の活発化が予想され、半導体市場は暦年後半から活況に転じる見込み

### <半導体テスト市場>

- CY24の半導体テスト市場は、生成AI向けの需要の高まりに連動したテスト需要が増加すると見込む一方で、スマートフォンやPCなど主要な民生機器向け需要の低迷は長期化しており、回復の時期について不透明感が継続
- SoCテスト市場は、HPC/AI向けを軸に需要の立ち上がりをCY24後半に期待するも、車載・産機・民生向けの弱含みから見通し引き下げ。メモリ・テスト市場は高性能DRAM向けの引き続き旺盛な需要を見込み、見通し引き上げ

	CY22実績	CY23実績	CY24推定
SoCテスト市場	約\$4.0B	約\$3.3B (1月時点推定:約\$3.3B-3.4B)	約\$2.9B - 3.2B (1月時点推定:約\$3.3B-3.6B)
メモリ・テスト市場	約\$1.2B	約\$1.1B (1月時点推定:約\$1.1B)	約\$1.4B - 1.7B (1月時点推定:約\$1.3B-1.6B)

Source: Advantest

### ○ 事業環境と半導体テスト市場の動向

- 2024年の半導体テスト市場は、HBMなどの高性能DRAMや、HPC/AIなど高機能半導体向けを軸に、需要の増加への期待は不変ですが、スマートフォンやPCなど主要な民生機器向け需要の低迷は長期化しており、回復の時期について不透明感が継続しています。
- 2024年のSoCテスト市場規模は、29億米ドルから32億米ドルのレンジと、3か月前の想定からおよそ4億米ドル引き下げました。これまでの高水準な設備投資がなされた自動車や産業機器関連では、これまでテストキャパシティの拡充が進みました。それに従い成熟半導体向けの顧客での設備投資は一服が見込まれ、今後のテストキャパシティ消化に伴い、新たなテストへの需要も弱含みを見込みます。
- 2024年のメモリ・テスト市場は、14億米ドルから17億米ドルのレンジと見通しを1億ドルほど引き上げます。高性能DRAM向けの領域では、顧客の生産計画の増加や、品質保証強化の動きに連動した顧客の強い需要は2025年にかけても続くとみており、高い成長率を見込みます。不揮発性メモリ向けのテスト需要は年後半から緩やかに回復するものと見込みます。
- これらを総合すると、2024年の半導体テスト市場は、ミッドポイントで前年比およそ5%増加するものと見込んでいます。
- 2025年以降を見据えた場合、比較的高い確度で市場規模が拡大するものと見ています。

## FY24業績予想

(億円)

	FY23 実績	FY24 予想	前年度比	
			増減額	増減率
			売上高*1	4,865
営業利益	816	900	+84	+10.3%
営業利益率	16.8%	17.1%	+0.3pts	
税引前利益	782	890	+108	+13.9%
当期利益	623	670	+47	+7.6%
当期利益率	12.8%	12.8%	+0.0pts	
研究開発費	655	670	+15	+2.3%
設備投資	208	220	+12	+5.8%
減価償却費	261	270	+9	+3.4%
為替レート*2	1米ドル	143円	140円	3円 円高
	1ユーロ	155円	155円	-

\*1:合計にはセグメント間の内部取引の消去分が含まれます

\*2:為替レート変動がFY24の営業利益に与える影響の最新見通しは、対米ドルが1円安時+7億円です。対ユーロは-3億円です

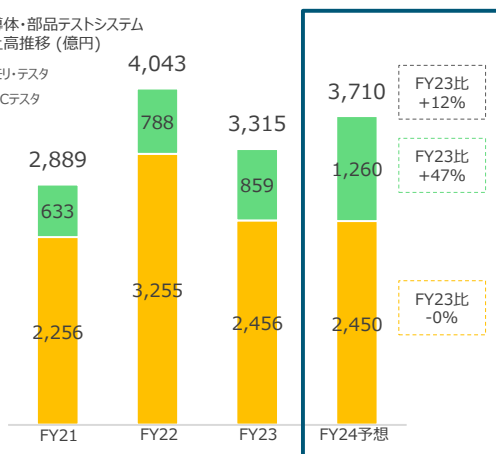
### ○ 2024年度の業績予想

- テスタ市場の回復を受けて、2024年度は売上高5,250億円、営業利益900億円、税引前利益890億円、当期利益670億円と増収増益を予想しています。
- HBM向けなど高性能DRAM向けは高水準な需要を見込むものの、上期は車載・産機・民生向けなどでの顧客の投資姿勢の弱含みにより、前年度下期より売上が落ち込むとみています。
- しかしながら、下期以降、HPC/AI向けなど高性能半導体向けの需要が市中の余剰設備を解消し、新たなテスト需要をけん引するものと想定しています。
- 主に製品ミックスの変動により、通期の売上総利益率は、48%程度と前年度から悪化を見込みます。営業利益率は17.1%を想定しています。
- 複雑化が進む半導体向けでの顧客の課題を解決を志向する、新たなテスト・ソリューションの評価など、高成長領域に向けたテストの付加価値向上に資する研究開発や設備投資は継続していきます。
- 予想の前提とした為替レートは、米ドルが140円、ユーロが155円です。
- 為替レート変動が2024年度の営業利益に与える影響の最新見通しは、通期で対米ドルでは1円安時+7億円、対ユーロでは-3億円です。

## FY24見通し（事業別）

半導体・部品テストシステム  
売上高推移（億円）

■ メモリ・テスト  
■ SoCテスト



### 半導体・部品テストシステム事業

#### <SoCテスト>

–HPC/AIについては、生成AI関連向けの強い需要を期待。一方で、車載・産業機器・民生向けでは一段売上が減少する見込み

アプリケーション別内訳	FY21	FY22	FY23	FY24(予)
コンピューティング・通信	60%	65%	60%	65%
車載・産業機器・民生・DDIC*	40%	35%	40%	35%

内訳比率は実数ではなく、5%近似値で丸めて表示しています

#### <メモリ・テスト>

–生成AI関連で高性能DRAM向け売上の伸長を予想

アプリケーション別内訳	FY21	FY22	FY23	FY24(予)
DRAM	60%	60%	90%	95%
不揮発性メモリ	40%	40%	10%	5%

内訳比率は実数ではなく、5%近似値で丸めて表示しています

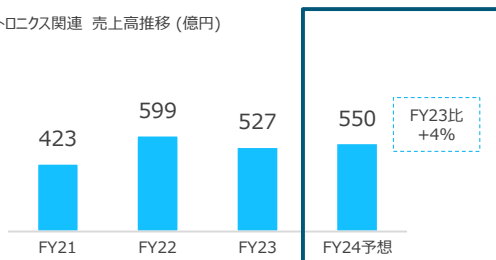
\* DDIC:ディスプレイ・ドライバーIC

### ○ 半導体・部品テストシステム事業の今期見通し

- SoCテスト売上は前年度並みの売上を予想しています。
- HPC/AIについては、生成AI関連向けの生産数量増加、複雑度増加を背景に強い需要を感じており、SoCテスト内の収益性に対するミックスは好転すると見込んでいます。新たな顧客の需要も期待しています。
- 一方で、スマートフォン向けでは3ナノ移行などの複雑度増加によるテスト需要増は期待できますが、スマートフォンの市況自体は停滞感があるため需要回復は不透明な状況です。
- また車載・産業機器・民生分野は今期、需要の弱さを見込んでいます。
- SoCテストはリードタイムが通常3-4か月程度に戻っており、それに伴い、顧客からのテスト需要の情報もより短期的な傾向となっています。そのため、年間を通しての業績予想の確度を高めることが難しくなっていますが、引き続き顧客との関係をより密に、商談確度を上げていきます。
- メモリテストは、生成AI関連で高性能DRAM向け売上の伸長を予想します。
- ただし現状のメモリ・テスト事業の収益性は満足できるレベルになく、その収益性の改善と向上が、私がCEOとして取り組むべき最も重要な課題の1つと認識しています。

## FY24見通し（事業別）

メカトロニクス関連 売上高推移（億円）

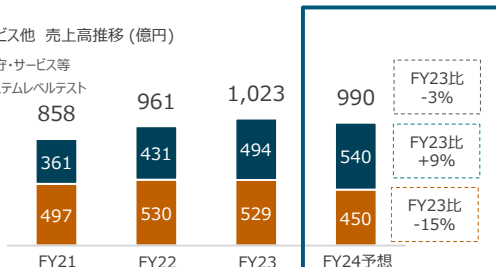


### メカトロニクス関連事業

–デバイス・インタフェース製品やテスト・ハンドラ、ナノテクノロジー製品の全ての事業で堅調な売上を予想

サービス他 売上高推移（億円）

■保守・サービス等  
■システムレベルテスト



### サービス他事業

–当社製品の設置台数の着実な伸びにより、保守サービスの需要は堅調

–システムレベルテスト事業は、民生機器関連での不透明感継続を背景に、前年度比で減収見込み

## ○ メカトロニクス関連、サービス他事業の今期見通し

- メカトロニクス関連事業は、テスト売上が伸びる中で、デバイス・インタフェースやハンドラでは堅調な売上を予想しています。ナノテクノロジー製品販売もやや増加する見通しです。
- サービス他事業は、前年度の並みの売上を予想します。
- サービス保守事業は、当社製品の設置台数の着実な伸びを受けて、底堅い需要を見込みます。
- SLT事業は、前年度比で減収見通しです。
- 2024年度は、スマートフォン向けを中心にSLTを採用する顧客拡大は進んでいるものの、まだ特定顧客の影響は少なくないビジネスであり、民生機器関連での不透明感が継続していることが足元の需要の伸び悩みにつながっています。
- SLT事業は、新興の事業領域であり、M&Aも活用しながら事業領域拡大に取り組んできました。2023年度では、車載やコンピューティング領域向けなど、新たなアプリケーション向けにも新規顧客の拡大を行うことができました。このビジネスは、高成長領域の複雑化が進む半導体の品質保証強化に不可欠であり、事業として将来的に成長できることを信じています。

## FY24の主要施策

### ・半導体の複雑化が進む高成長領域に向け、付加価値の高いソリューションの提供と供給体制の拡充

- ✓HBMなどの高成長領域の急峻なテスト需要の高まりに応じる供給体制のさらなる増強
- ✓先端技術の確立に挑むリーダー顧客の課題を把握し、最先端の試験技術開発と統合テスト・ソリューションを拡充
- ✓複雑な半導体の設計からシステムレベル、データ・アナリティクスまで、テスト工程を一貫してカバーする“Automation”の取り組みを通じさらなる顧客価値を創造

### ・収益性改善の施策を推進

- ✓HPC/AI,先端メモリなど高機能半導体における優位性の維持
- ✓今後の需要変動にも柔軟に追随するサプライチェーン管理および生産体制の高度化

### ○ 2024年度の主要施策

- ・ 2024年度の主要施策についてお話ししたいと思います。1つ目は、付加価値の高いソリューションの提供と供給体制の拡充を掲げます。
- ・ HBMなどの、高成長領域の急峻なテスト需要増に対して、さらなる供給体制の増強に取り組みます。
- ・ そして、このような先端技術の確立に挑む、リーダー顧客の課題を把握し、その本質をとらえることで、最先端の試験技術の開発と統合的なテスト・ソリューションを拡充していきます。
- ・ 複雑な半導体の設計からシステムレベル、データ・アナリティクスまで、テスト工程を一貫してカバーする“Automation”の取り組みを通じ、さらなる顧客価値を創造していきます。
- ・ 2つ目の主要施策としては、収益性改善の施策を推進することです。
- ・ すでに築き上げてきた、AI/HPCや先端メモリなど高機能半導体の試験における優位性の維持を目指します。
- ・ 需要変動にも柔軟に追随するサプライチェーン管理、および生産体制の高度化にも引き続き取り組んでいきます。

## 中長期経営方針の改定

- MTP1・MTP2における製品ポートフォリオの拡充、事業領域の拡張、顧客サポート力の強化といった取り組みは、当社の成長基盤をより強固なものに
- 第3期中期経営計画（MTP3）を含め、当社の新たな中長期経営方針を策定中
  - 半導体ますます複雑化する中、“Automation”を通じてさらなる効率性をもたらすことで、コア市場の成長率を上回る成長を引き続き実現
  - 収益拡大に向け、オペレーショナル・エクセレンスへの取り組みを全社をあげて推進
  - 近隣市場や新たな事業領域への展開を継続
  - ネットゼロ実現を軸としたサステナビリティの取り組み強化
- 中長期経営方針説明会  
2024年6月25日（火）午後（日本時間）の開催を予定

### ○ 中長期経営方針の改定

- MTP1およびMTP2では、製品ポートフォリオの拡充や事業領域の拡張、顧客サポート力の強化といった取り組みを通じて、当社の成長基盤をより強固なものにしてきました。
- このような成果を今後の礎とする中長期的な経営方針や成長の道筋を現在検討しています。いくつかの核となる戦略としては次の4つです。
- 半導体ますます複雑化する中、“Automation”を通じてさらなる効率性をもたらすことで、当社の今後のコア市場の成長率を上回る事業成長を引き続き目指します。
- オペレーショナル・エクセレンスへの取り組みを全社をあげて推進し、収益拡大を図ります。
- 近隣市場や新たな事業領域への展開を継続します。
- ネットゼロ実現を軸としたサステナビリティの取り組みを強化していきます。
- 経営指標含めた詳細については、別途6月に中長期経営方針説明会を予定しており、ご説明したいと考えています。



*Facing the future together*